

Microchip 社、高電力密度と容易なシステム統合を実現する 新しい DualPack 3 IGBT7 モジュールを発表

需要が拡大しているモータドライブ、データセンター、
持続可能性アプリケーション向けに 6 製品を発売

2025 年 9 月 17 日[NASDAQ: MCHP] - 効率と信頼性に優れた小型電源ソリューションに対するニーズが拡大している事を背景に、電力密度の向上とシステム設計の簡素化を実現する電源管理デバイスへの需要が増大しています。Microchip Technology Incorporated(日本法人: 東京都港区浜松町、代表: 櫛晴彦 以下 Microchip 社)は本日、先進の IGBT7 技術を利用した [DualPack 3 \(DP3\)パワーモジュール](#)の新ファミリを発表しました。このファミリには、1200V と 1700V の電圧および 300~900A の大電流に対応する 6 製品が含まれます。新しい DP3 パワーモジュールはシンプルで低コストな小型電源コンバータへの需要の拡大に応えるように設計されています。

これらのモジュールは最新の IGBT7 技術を活用しており、IGBT4 デバイスと比べて最大 15~20%の電力損失を削減し、過負荷の温度が最大 175°C に上昇しても信頼性の高い動作を継続するように設計されています。また、高電圧スイッチング中の保護と制御が強化されているため、産業用ドライブ、再生可能エネルギー、トラクション、エネルギー貯蔵、農業用車両などの用途で電力密度、信頼性、使いやすさを最高レベルに引き上げる事ができます。

DP3 パワーモジュールは位相レグ構成で提供され、フットプリントが約 152mm×62mm×20mm と小さいため、フレームサイズを大型化して出力電力を増加させる事ができます。このタイプの先進パワーパッケージでは、複数モジュールを並列接続する必要がなく、システムを簡素化して(BOM)部品コストを削減できます。また、業界標準の EconoDUAL™パッケージに対するセカンドソース オプションを提供しているため、顧客は高い柔軟性とサプライチェーン セキュリティを確保できます。

Microchip 社の高信頼性および RF 事業部門副社長の Leon Gross は次のように述べています。「IGBT7 技術を使った新しい DualPack 3 モジュールは、高性能を維持しながらも設計の複雑さとシステムコストを削減する事ができます。設計プロセスをさらに効率化するため、Microchip 社のマイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、セキュリティ、コネクティビティ等の部品と共にこのモジュールを包括的なシステムソリューションの一部として統合する事で、開発から市場投入までの期間を短縮する事ができます」

DualPack 3 パワーモジュールは、汎用的なモータドライブ アプリケーションに適しており、dv/dt、駆動システムの複雑さ、高い伝導損失、過負荷耐性の欠如等の一般的な課題に対処します。

Microchip 社は、アナログデバイス、Si(シリコン)と SiC(シリコン カーバイド)の電源技術、dsPIC® DSC(デジタルシグナルコントローラ)、標準、改良、およびカスタムのパワーモジュール等、幅広い電源管理ソ

Microchip 社、高電力密度と容易なシステム統合を実現する新しい DualPack 3 IGBT7 モジュールを発表

2-2-2-2

リレーションのポートフォリオを提供しています。Microchip 社の電源管理用製品の詳細は [ウェブページ](#) をご覧ください。

価格と在庫/供給状況

DualPack 3 パワーモジュールは本日より量産受注を開始いたします。ご購入は Microchip 社の [正規代理店](#) にお問い合わせ頂くか、Microchip 社の [オンラインストア](#) をご利用ください。

リソース

高画質の写真は報道関係専用窓口までお問い合わせ頂くか、Flickr でご覧ください。掲載に許可は不要です。

- アプリケーション画像: www.flickr.com/photos/microchiptechnology/54729936654/sizes/l

Microchip Technology 社について

Microchip 社は、新しい技術を市場投入する際の重要な課題を解決するトータルシステム ソリューションを通じて、革新的な設計をより簡単に実現する事に尽力しています。使いやすい開発ツールと包括的な製品ポートフォリオにより、コンセプトの創出から完成までの設計プロセス全体にわたってお客様をサポートします。Microchip 社は本社をアリゾナ州 Chandler に構え、産業、車載、民生、航空宇宙と防衛、通信、コンピューティングの市場で優れた技術サポートとソリューションを提供しています。詳細は Microchip 社ウェブサイト (www.microchip.com) をご覧ください。

###

Note: Microchip 社の名称とロゴ、Microchip ロゴ、dsPIC は米国およびその他の国における Microchip Technology Incorporated の登録商標です。その他の商標は各社に帰属します。

詳細については、以下にお問い合わせください。

Helen Tang (Microchip 社):

(メール: Helen.Tang@microchip.com)

松田、仙場 (共同 PR):

(メール: mchp-pr@kyodo-pr.co.jp)

報道関係者の方へ: このニュースリリースのメールによる配信については、共同 PR 株式会社 松田もしくは仙場まで電話(03) 6260 4863 またはメール mchp-pr@kyodo-pr.co.jp でお問い合わせください。